

www.teldevice.co.jp

当社のホームページでは、会社案内、製品・技術情報、IR情報など、豊富なインフォメーションを発信しています。



当社IRサイトは、大和IRの「インターネットIRサイトの優秀企業190社」(2004年4月20発表)に選ばれました。今後も、IR情報の充実に努めてまいります。

IRカレンダー

- 4月 決算発表および説明会
- 6月 定時株主総会
- 7月 1Q決算発表
- 9月 個人投資家説明会
- 10月 中間決算発表および説明会
- 1月 3Q決算発表
- 2月 個人投資家説明会(予定)

お問い合わせ先

総務部 TEL : 045-474-7024
 FAX : 045-474-7092
 E-mail : ir-info@teldevice.co.jp



Investors Guide 2004

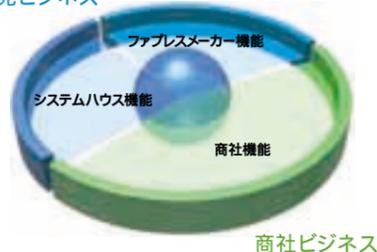
社長メッセージ

東京エレクトロニクス(TED)は、世界トップクラスの半導体製造装置メーカーである東京エレクトロニクス株式会社の、電子部品部門が分離・独立して設立されました。

お客様に満足していただける品質と環境への配慮を方針に、商社機能・システムハウス機能・ファブレスメーカー機能を備えた新しい形態の専門商社です。

今後も、お客様をはじめ広く社会から信頼されるNo.1技術商社を目指しています。

開発ビジネス



profile

1963年 東京エレクトロニクス(株)の前身である(株)東京エレクトロニクス研究所を設立

1965年 電子部品の販売を開始

1986年 3月

東京エレクトロニクス(株)の子会社として、当社の前身であるテル管理サービス(株)を設立

1990年 9月

東京エレクトロニクス デバイス(株)へ社名を変更、電子部品の販売を開始

1998年 7月

東京エレクトロニクス(株)から、電子部品部門に関する営業を全て譲り受け、販売を開始

2003年 3月

東京証券取引所 市場第二部に上場

2004年 1月

中国・上海に子会社の上海華桑電子有限公司設立



取締役社長 砂川 俊昭

はじめに

投資家の皆様には、平素から格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は2004年3月期の活動方針として、高付加価値商品の販売推進、デジタルコンシューマ市場向け商品の開拓、開発ビジネスの拡大、の3つを掲げ、技術商社としての地位の向上に努めてまいりました。

当期の業績におきましては、エレクトロニクス市場の追風もありましたが、技術力を必要とする高付加価値商品や新規仕入先商品を積極的に販売したことなどから、前期比増収増益となりました。また、2004年1月にカスタムICの設計受託業務を行う子会社を中国上海市に設立するなど、開発ビジネスの拡大に向けた取り組みも行ってまいりました。

今後も、お客様のニーズに柔軟に応えられるマーケティング体制の構築、安定した収益の確保と収益率の向上に取り組んでまいります。

営業拠点の拡充

よりお客様に密着した営業展開を実現するために、2003年10月には、長岡・岡山の2ヶ所にサテライトオフィスを開設し、全国13拠点体制にいたしました。

上海子会社設立

設計・開発体制強化の一環として、2004年1月、中国・上海に「上海華桑電子有限公司(通称:東京エレクトロニクス デバイス上海)」を設立いたしました。



株式分割

投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整え、株式の流動性を向上させるため、2003年9月30日を基準日として、2003年11月20日付で1株につき2株の割合で株式の分割を実施いたしました。

同様に2004年7月31日を基準日として、2004年9月15日付で1株につき2株の割合で株式の分割を行います。

新ブランドの命名

2004年6月に従来より提供しておりました自社開発商品やサービス等に、新ブランド「inrevium(インレビウム)」と命名いたしました。これを機に自社の商品やサービスがさらに充実するように注力してまいります。

中期の課題

マーケティング

継続して新しい商品をお客様に提供し、市場変化に迅速に対応するために、マーケティングを重視してまいります。

収益の確保

高付加価値商品を幅広く販売し、リスクを分散させることで、安定した利益成長に努めてまいります。

収益率の向上

開発ビジネスに注力することにより、商社ビジネスでは得られない収益率を追求してまいります。

2005年3月期の活動方針

営業拠点の拡充

2004年4月に京都サテライトオフィスを開設。さらに2ヶ所の開設を予定しております。

高付加価値商品の売上拡大

カスタムIC、アナログICなど、技術サポート力を活かした高付加価値商品を幅広く販売してまいります。

開発ビジネスの体制強化

開発ビジネスの体制を強化し、収益率の向上を図ってまいります。

将来の業績見通し等に関する注意事項
このインベスターズガイドは、2004年7月1日時点で作成されています。ビジネス戦略、業績予想等の将来の見通しに関する事項は、その時点で入手可能な情報から東京エレクトロニクス デバイスの経営者の判断に基づいて書かれており、経営環境の変化により修正することがあります。したがって、当社は、内容の正確性、信頼性等、一切保証しませんので御了承下さい。最新情報については、公表資料または当社Webサイトを御参照下さい。

目次

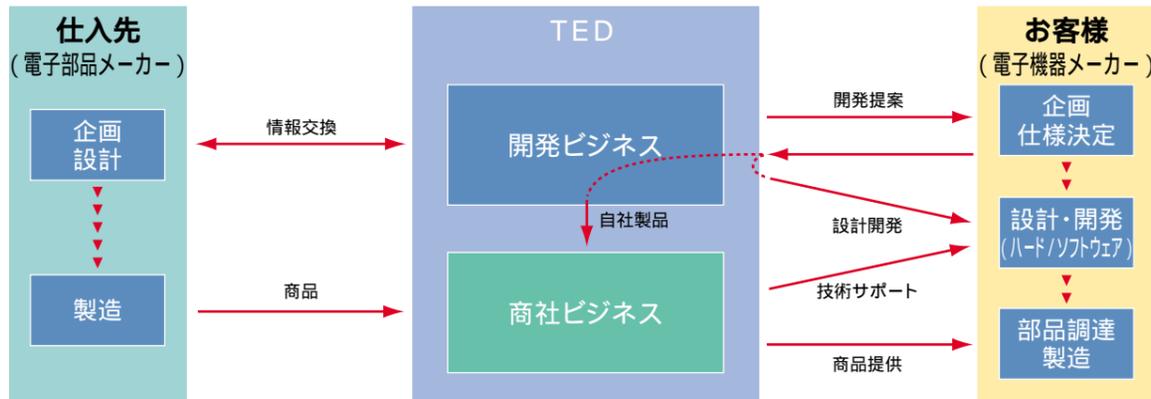
社長メッセージ	1	業績レビュー	12
会社の位置づけ	3	財務諸表	13
商社ビジネス	5	財務データ	15
開発ビジネス	7	投資家情報	18
マーケット情報	11	Webサイト情報	裏表紙

会社の位置づけ

当社は商社ビジネスと開発ビジネスからなる、新形態の技術商社です。急速な技術変化が求められるエレクトロニクス業界において、技術力・開発力・マーケティング力をベースに、付加価値の高い対応を迅速に行える商社です。

これにより、お客様が新商品の企画を行う初期の段階から、設計・開発、そして製造・量産に至るすべての段階で、常に最適なソリューションをタイムリーにご提供します。

ビジネス概念図

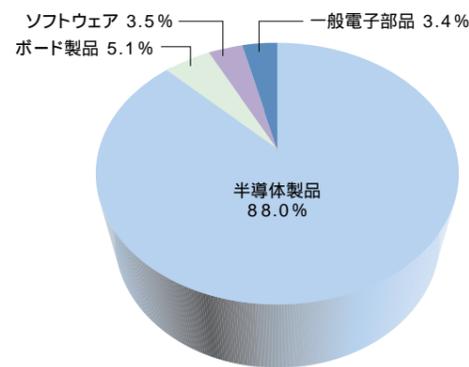


品目別構成

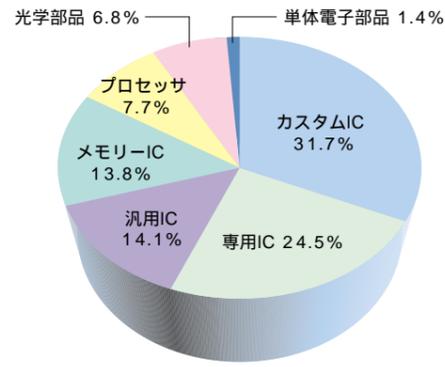
当社の商品構成は、半導体製品が大半を占めています。半導体製品に関連するボード製品・ソフトウェア・一般電子部品も取り揃えて、お客様の多様なニーズに応えています。

半導体製品の中では、カスタムICや専用ICなど、技術力を必要とする付加価値の高い商品の比率が高くなっています。

品目別売上構成(2004年3月期)



半導体製品内訳(2004年3月期)



【半導体製品】シリコンなど半導体を材料に製造された製品。一般にICと呼ばれる。
 【ボード製品】プリント基板上に多数のICや電源・コネクタなどを搭載した製品。
 【ソフトウェア】コンピュータが理解できる方法で表現された処理手順(プログラム)。
 【一般電子部品】電源やコネクタ、ケーブルなど半導体製品以外の電子部品。

【カスタムIC】お客様の仕様に応じて作られる固有IC。ASICやPLDが代表的製品。
 【専用IC】通信や画像処理など、特定用途に作られた専用のIC。
 【汎用IC】色々な用途に共通して使用されるIC。アナログICやロジックICなど。
 【メモリIC】記憶用のIC。書き込みと読み出しが可能なRAM、読み出しのみのROMなど。
 【プロセッサ】コンピュータの中心となる頭脳として、演算・制御機能をもつIC。
 【光学部品】電気を光に変換して使用する電子部品。
 【単体電子部品】増幅や整流など、電気の基本機能を持つ部品。

取扱商品一覧

カテゴリー	主な商品	主な用途	主な仕入先名(アルファベット順)
半導体製品	カスタムIC ASIC PLD(FPGA, CPLD)	デジタル家電、交換機 携帯電話・PHS、計測器 OA機器、放送機器	富士通 ザイリンクス
	専用IC 通信・ネットワーク用 画像処理用 インタフェース用 セキュリティ用 周辺制御用	デジタル家電 インターネット接続機器 LAN機器 交換機、通信端末 プリンター、プロジェクタ テレビ、デジタルカメラ、DVD カーナビゲーション カーオーディオ	AMD、キャビウム、コネクサント ユーティリティデバイス、フリースケール 富士通、富士通メディアデバイス、IDT インフィニオン、インターシル、レジェリティ ピクセルワークス、セーフネット 新光電気工業、サイバーコア SiS、TI、TED、タンドラ ザイコー、ザーリンク
	汎用IC アナログ ロジック	携帯電話、FA機器、携帯端末 PC周辺機器、LAN機器	富士通、インフィニオン、インターシル リニアテクノロジー オン・セミコンダクター、ポテンシア、TI
	メモリIC フラッシュ DRAM/SRAM FRAM E ² PROM	携帯電話、通信機器 PC周辺機器、テスター カーオーディオ	富士通、IDT ラムトロン、ザイコー
	プロセッサ マイクロプロセッサ マイクロコントローラ	DSP パソコン、携帯端末、POS プリンター、交換機	AMD、フリースケール、富士通 インフィニオン、TI
	光学部品 LED フォトカプラ 光ファイバ レーザー	IrDA 携帯電話、交換機、携帯端末 FA機器、パソコン	アジレント ユーティリティデバイス ザーリンク
	単体電子部品 ダイオード トランジスタ	携帯電話、パソコン プリンター	インフィニオン、インターシル オン・セミコンダクター
	ボード製品 CPUボード VMEボード コンピュータテレフォニー I/Oボード 評価ボード	交換機、CTI、サーバ FA機器、医療機器、計測器 半導体製造装置	インテル モトローラ、PFU、TED ウッドヘッド
	ソフトウェア OS BIOS 開発ツール RTOS アプリケーション	POS、周辺装置、FA機器 カーナビ、コピー機	メトロワークス マイクロソフト、フェニックス TED、ベンチャーコム
	一般電子部品 パネルPC 電源 コネクタ ICソケット 静電気・EMC対策製品	LCD ビデオカメラ、FA機器 医療機器、産業機器	コーセル、デジタル 富士通ディスプレイテクノロジー コービン、スリーエム ウィンチェスター

(注)社名は、敬称を省略し略称を使用しています。

【ASIC】高性能が望めるが、開発期間が長くなるカスタムIC。
 【PLD】プログラム可能な論理素子のカスタムIC。ASICより短期開発が可能。
 【フラッシュメモリ】データを電氣的に保存するメディア。電源が切れても保持が可能。
 【LED】電気を流すと発光するダイオード。ランプや表示器に使用。
 【フォトカプラ】電気信号を光に変換して伝達する素子。電氣的な絶縁が利点。

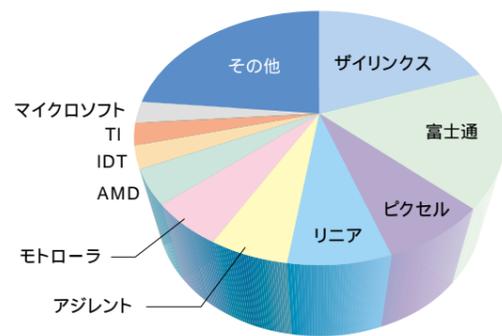
【IrDA】規格団体により制定された赤外線使用の通信機能。モバイル機器などで採用。
 【ダイオード】電流を一方に流す整流作用を持つ電子部品。
 【コンピュータテレフォニー】コンピュータと電話を融合させたサービスの総称。
 【BIOS】キーボードやディスプレイなど基本的なデバイスを制御するソフトウェア。
 【LCD】液晶を使用したディスプレイ。ノートPCなどに使用。

世界中の電子部品メーカーに幅広くマーケティングを行い、最新の商品をラインナップしています。また、お客様に最適な提案を行うため、お客様や仕入先別の営業と、技術サポートを行うエンジニアが有機的に結合した体制となり、きめの

細かいサービスを提供しています。さらに物流面では、最新のコンピュータ・ネットワークシステムによる迅速かつ効率的なロジスティクスを構築しています。

仕入先の概要

仕入先別売上構成(2004年3月期)



(注)社名は、敬称を省略し略称を使用しています。

売上分布予想

ライニクス社、富士通(株)、リニアテクノロジー社は、引き続き売上高上位をキープし、10~20%の伸び率を予想しています。

新規仕入先のテキサス・インスツルメンツ社、インフィニオン社は高い伸び率での推移、ピクセルワークス社、アジレント社、フリースケール・セミコンダクタ社、マイクロソフト社は横ばいでの推移を予想しています。

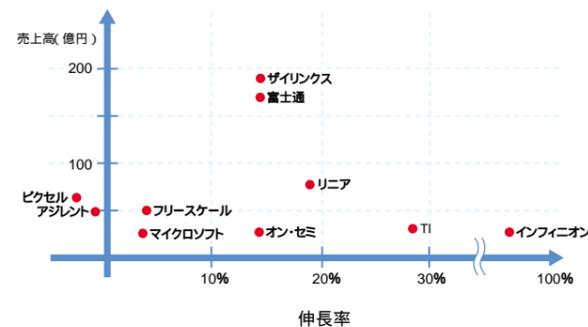
*モトローラ社半導体部門は、2004年4月にフリースケール・セミコンダクタ社に社名変更しています。

売上構成

当社の仕入先は、海外の有力半導体メーカーを中心とした約45社で、国内での販売実績シェアはほとんどが1位または2位の企業です。

構成比では、第1位のライニクス社が約19%、第2位の富士通(株)が約17%、第3位のピクセルワークス社と第4位のリニアテクノロジー社がそれぞれ約8%となっています。

主要仕入先売上予想



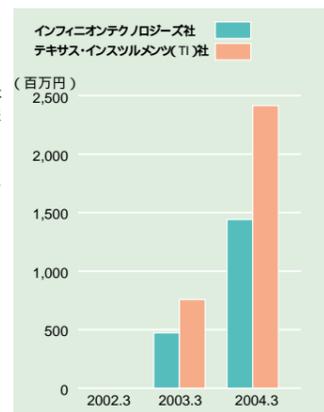
(注)社名は、敬称を省略し略称を使用しています。仕入先の業績には連動いたしません。

主要仕入先の紹介

- ライニクス社**
急成長中のプログラマブルロジックソリューションで世界のトップ企業。
- ピクセルワークス社**
プロジェクトやLCDテレビの画像処理用製品で、世界シェア80%以上の企業。
- リニアテクノロジー(LTC)社**
幅広い分野で利用されるアナログIC製品で、世界をリードする専門企業。
- アジレント・テクノロジー社**
1999年にHP社から分離した企業で、光エレクトロニクスや無線通信分野で高い実績を持つ。
- フリースケール・セミコンダクタ社**
組み込み用プロセッサの生産では世界有数の企業。幅広い半導体商品で世界をリード。
- アドバンスド・マイクロ・デバイス(AMD)社**
IC専業メーカーとしてグローバルに活躍する、インテル社の競合企業。
- インテグレートッドデバイステクノロジー(IDT)社**
CMOSプロセスを活用した幅広い製品を提供。特に通信ネットワーク製品の評価が高い。
- マイクロソフト社**
世界標準のOSと呼ばれるWindowsなどで有名な企業。

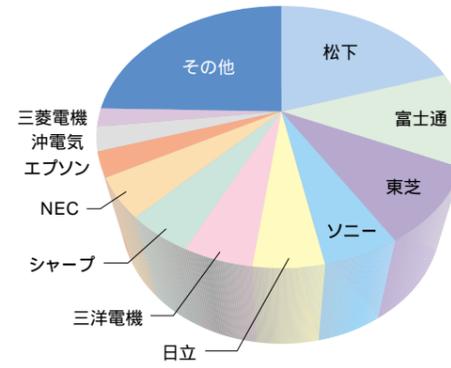
新規仕入先の紹介

- インフィニオンテクノロジー社**
シーメンス社の半導体部門が分離独立した企業。最先端の半導体ソリューションを提供する。
- テキサス・インスツルメンツ(TI)社**
世界的な半導体企業で、DSP(デジタル・シグナル・プロセッサ)のシェアは世界1位。



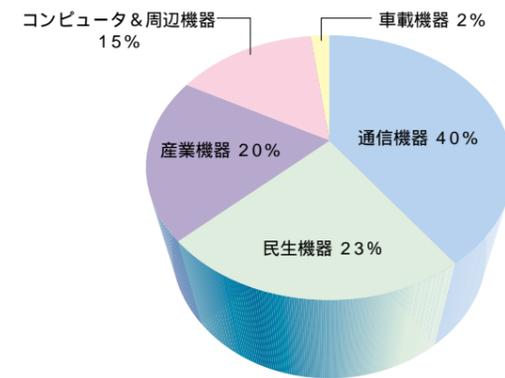
お客様の概要と主な用途

お客様別売上構成(2004年3月期)



(注)社名は、敬称を省略し略称を使用しています。

用途別売上構成(2004年3月期)



当社のお客様は、電子機器メーカーを中心に1,000社以上にのびます。売上高上位は、松下グループ、富士通グループ、東芝グループ、ソニーグループ、日立グループなど、国内の大手電子機器メーカーが占めています。

また、商品の用途別売上では、通信機器、民生機器、産業機器、コンピュータ&周辺機器など、幅広い分野で実績を上げています。

用途	主なアプリケーション
通信機器	インターネット接続機器 携帯電話・交換機・基地局
民生機器	デジタルカメラ・デジタルビデオカメラ チューナー・液晶テレビ・プラズマテレビ DVD
産業機器	セキュリティ監視機器・医療機器 放送機器・テスター・半導体製造装置
コンピュータ&周辺機器	プリンター・プロジェクタ・POS・PC ワークステーション・汎用コンピュータ
車載機器	カーナビゲーション・カーオーディオ

高付加価値の技術サポート

仕入先ごとに、専属のフィールド・アプリケーション・エンジニア(FAE)を配置し、企画・製造の各段階を通してきめの細かい技術サポートを行っています。お客様に対して新製品の技術説明や提案、技術問い合わせへの対応、不具合問題の解決、品質情報の提供などを行うと同時に、仕入先に対しても商品評価や技術的な調査への協力を行い、問題解決のできる技術商社として高い信頼を得ています。



開発ビジネス

販売、設計・開発ノウハウを活かし、お客様の仕様に基づくデザインサービス(システムハウス機能)と、お客様のニーズに応える自社ブランド商品の提供(ファブレスメーカー機能)

を行っています。開発ビジネスの推進により、お客様が商品化を検討する初期段階から連携することで、当社への信頼と付加価値を向上させています。

開発ビジネスの狙い

商社でありながら開発ビジネスへ注力する目的は、ビジネス領域のさらなる拡大と高付加価値化による利益率の向上にあります。お客様における商品開発の企画・設計段階から参加することにより、単に設計受託業務を拡大するだけで

なく、適切な開発提案を行うことによって、取り扱い商品の採用枠の拡大や自社ブランド商品の開発など、新たなビジネス機会の創造を期待しています。

高付加価値事業への取組み



設計開発センター(DDC)

1985年に開設された設計開発センターは、日本最大級の規模を誇ります。設計・開発の経験豊富なエンジニアをそろえ、常に最新の技術動向を先取りした設備を導入し、製品開発の支援を行います。お客様のご要望に応える設計受託業務(デザインサービス)と、市場ニーズを先取りした自社ブランド商品の開発を、スピーディかつ効率的に行っています。

DDCでは、デジタルAV機器や通信機器、コンピュータ周辺機器、OA機器など、幅広い用途に対応した大規模で高品質なLSI製品の設計開発を多数行い、高い評価を得ています。

また、DDCの開発経験を営業提案や技術サポートに活かせるのも技術商社ならではの強みです。



新ブランドの命名

ブランド名設定の狙い

新ブランド「inrevium(インレビウム)」命名の目的は、自社の商品やサービスをさらに充実させ、売上高の拡大や収益率の向上を図ることです。

新ブランドは、当社保有の技術や情報を利用して提供する商品やサービスの総称として使用するとともに、産学連携商品、仕入先商品と組み合わせる付加価値を高めた商品、お客様のニーズにより開発した商品等、全社的に使用していきます。

ブランド名の意味

新ブランド「inrevium」は、Intellectual(知的な)、Inter(内部の)、Revolutionary(革新的な)、-ium(要素)等の単語の一部を組み合わせた造語です。当社の持つ情報・技術・サービスの商品化を通じて、お客様の抱える課題を解決し、事業活動に貢献していきたいという強い意志を込めたものです。

inrevium

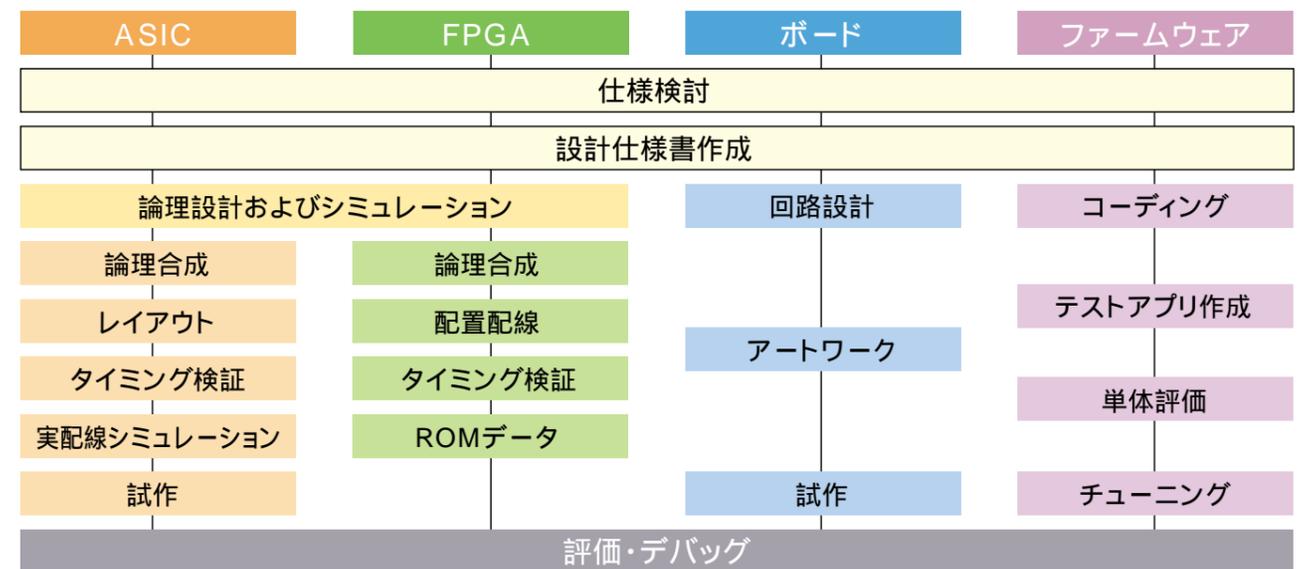


製品イメージ

開発ビジネス 売上高推移・計画



デザインフロー例



設計受託業務(デザインサービス)

技術商社ならではの情報ネットワークと、高度な技術や豊富な実績を活かして、お客様の委託に基づくカスタムICの設計、ボードの設計、各種デバイスドライバやファームウェアの開発、IPと呼ばれる機能マクロを取り込んだ設計などに対応します。設計受託業務を活用することにより、新商品の開発におけるお客様の設計工数を削減すると同時に、経験豊

富な専門家に任せることで設計リスクの軽減や最新技術の活用、設備投資や維持費の低減などが容易に行え、高性能商品の早期完成が可能となります。

また、効率的な商品開発を支援する評価ボードやIPも多数取りそろえています。

デザインメニュー

FPGA: ザイリンクス社の代理店ならではの最新ノウハウを活かし、汎用言語による論理設計および検証から、ターゲットデバイスへのマッピング、ROMデータ作成までのFPGA内部回路設計を提供します。

ASIC: FPGAでの機能評価からASIC設計までの一貫した設計サポートや、最適な開発インタフェースとファウンドリーの選択で、開発期間の短縮化を実現します。

ボード: 要望する機能が単体ICで実現できない場合には、周辺回路まで含めたボード設計にて対応します。

ドライバ: PCIやUSB等、各種デバイスドライバの開発が可能です。

IP: 自社設計のIPラインアップやサードパーティの提供IP、あるいはIPの共同開発など、活用が必須になる機能マクロを取り込んだデザインにも対応します。

ファームウェア: ハードウェアを熟知したエンジニアにより、各種CPUやOSに対応したファームウェアの開発を行います。

設計コンサルティング: 豊富な設計・開発経験を活かし、高度で幅広いコンサルティングを行います。

開発を支援する商品の例

評価用ボード: メモリやインタフェース、アプリケーションの開発を、効率的に支援する評価ボードを提供しています。

評価用ソフトウェア: 特定ICの評価用に、API(アプリケーション・プログラム・インタフェース)を用意しています。

IP: I/O制御や基本演算機能など、FPGAやASIC向け機能モジュールをRTLソースにて提供しています。



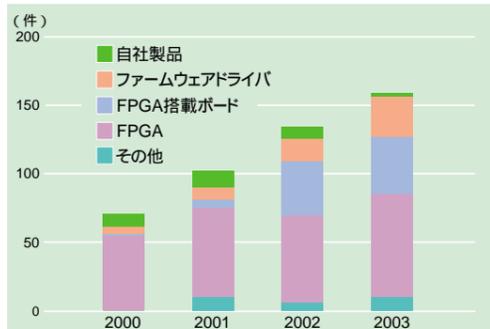
DDR-SDRAM評価ボード



DVI評価ボード



開発件数の推移



お客様のニーズに応えた自社ブランド製品

ASIC開発件数/平均ゲート数推移



【ファームウェア】ハードウェアの制御を行なうため、機器に組み込むソフトウェア。
【サードパーティ】主メーカーの製品に、対応する製品を作っているメーカー群。

自社ブランド商品

電子部品商社として長年培ってきた開発、マーケティングの経験を活かして、市場ニーズにベストフィットした独自商品の企画・開発を行っています。

自社ブランド商品には、メモリ制御や画像処理、通信インタフェースなど自社で保有する最先端の技術を活用した商品や、豊富な取り扱い商品と組み合わせる付加価値を高めた商品、大学や研究機関と共同で開発した産学連携商品、お客様のニーズに応じて開発した商品などがあります。



保有技術を活用した商品の例

デジタルカメラや携帯電話などに使用されるSDメモリおよびSDIOカードのコントローラや、NANDフラッシュメモリおよびSmartMedia、xD-Picture Cardのコントローラ、銀行端末や産業用機器に使用される拡張I/O用や通信用、装置内ネットワーク用LSIなどを用意しています。



携帯電話などに使用されるソフトウェア



高精度ディスプレイ評価ボード

取り扱い商品と組み合わせた高付加価値商品の例
ピクセルワークス社イメージプロセッサと組み合わせ、プロジェクタやプラズマテレビに使用されるI/O拡張や高精度同期信号分離出力用LSI、およびザイリンクス社FPGAと組み合わせ、通信機器やデジタル家電に使用されるローコストメモリソリューションなど、潜在的な問題を解決するコンパニオンチップを提供しています。

産学連携の最先端商品の例

パソコンに使用され、高度なセキュリティと大容量で高速なデータ転送を実現する暗号化IPや、パソコンのPCIスロットに装着し、天体軌道シミュレーションや遺伝子解析などに使用できる超高速並列演算用ボードなどを用意しています。



並列演算PCIボード

拡大基調に乗った日本の電子工業

2003年の日本の電子工業は、国内生産額で前年比6.6%増の19兆296億円と、3年ぶりにプラスに転じています。堅調なアジア向け輸出や設備投資の回復、高機能デジタル機器の増産に伴う半導体が大幅に需要回復したことによります。

2004年もデジタル家電を牽引役に概ね好調な推移が予想されています。引き続き需要の高い民生用電子機器は前年比11.5%増と2年続けて2桁増の2兆5,330億円、産業用電子機器は1.6%増とほぼ横ばいの7兆7,249億円、電子部品・デバイスは9.2%増の10兆558億円と予想されています。

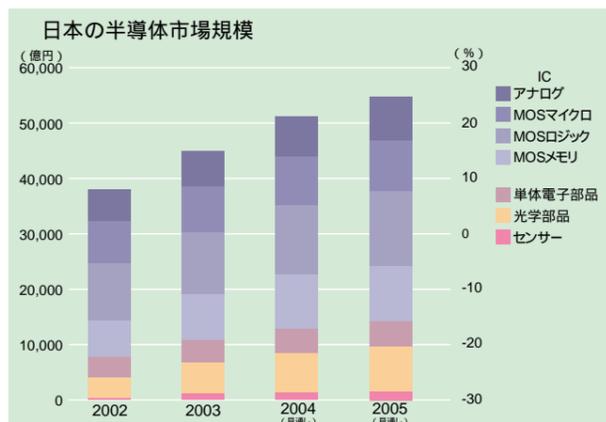


出所: 電子情報技術産業協会

緩やかな伸び率を示す半導体市場

WSTS(世界半導体市場統計)によると、2003年の世界半導体市場は前年比18.3%増の1,664億ドルとなっています。2004年は前年比28.4%増の2,136億ドル、2005年は8.5%増の2,317億ドルと予想されています。

日本の半導体市場は、2002年の前年比5.3%増から2003年は前年比18.3%増と回復しました。2004年には前年比13.9%増の約5.1兆円、2005年は6.8%増の5.5兆円と予想されています。



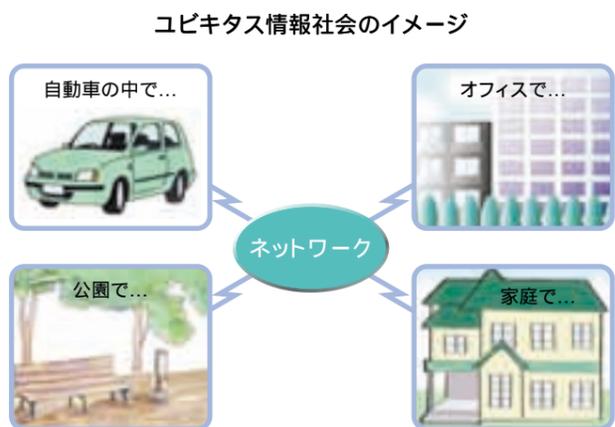
出所: WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)日本協議会

情報ネットワーク社会の拡大

2003年度の日本市場は、薄型テレビ、DVDレコーダ等のデジタル家電やカメラ付携帯電話が引き続き好調であり、さらにカーナビゲーションなどの車載電子機器の需要が新たな牽引役となりました。

2004年度も引き続き、地上デジタル放送に伴うデジタルテレビの需要増などデジタル家電や、携帯電話の買替需要が継続すると予想されます。今後、ユビキタス情報社会がより身近になると、コンピュータ化やネットワーク化が一層進展し、各機器の高機能化や小型・軽量化がさらに求められます。

【ユビキタス情報社会】
PCや携帯電話だけでなく、デジタル家電、自動車、家具などさまざまなものにコンピュータが入り、それらがネットワーク化されることで、いつでも、どこからでも必要な情報にアクセス可能な社会。



2004年3月期業績報告 (2004年4月28日)

エレクトロニクス業界においては、景況感の改善を受けて企業向けにパソコンの需要が回復したこと、カメラ付き機種や第三世代機への移行により携帯電話の需要が増加したことおよびデジタルカメラ、DVDレコーダ、薄型テレビ(PDP・液晶)などのデジタル家電に対する需要が旺盛であったことから、半導体電子部品市況は回復基調となりました。

このような状況のもと、当社は技術サポートを要する高付加価値商品の販売に注力するとともに、顧客の製品企画段階から参画する提案営業により、取扱商品の採用拡大、新

規商品の採用促進に努め、2003年10月に長岡市と岡山市に営業拠点を開設するなど、顧客ニーズに沿った営業展開を行いました。また、カスタムIC、ボード製品、ソフトウェアの設計受託業務においても、設計、開発業務を強化すべく2004年1月に中国上海市に子会社を設立するなど、積極的に推進しました。

この結果、当期の売上高は前期比8.8%増の857億3千8百万円、経常利益は前期比14.7%増の29億5千2百万円、当期純利益は前期比18.0%増の16億8千万円となりました。

【品目別概況】

半導体製品
薄型テレビ(PDP・液晶)など民生機器向けに用途を拡大しているPLD(プログラマブルロジックデバイス)を主力とするカスタムICや、主に携帯端末の電源用に使用する汎用アナログICなど技術サポートを要する高付加価値商品の拡販に努めました。また、新規仕入先商品が半導体試験装置やATM(現金自動預払機)などの産業機器向けに伸長した結果、当期の売上高は、前期比8.5%増の754億6千8百万円となりました。

ボード製品
企業収益の改善を背景に設備投資が増加したことから、PCマザーボード、VMEボードなどFA関連装置向け販売が

堅調であった結果、当期の売上高は、前期比26.0%増の43億2千5百万円となりました。

ソフトウェア
幅広い技術サポートを提供しながら組み込みシステム機器向けなどに各種OS、ツールの拡販に努めた結果、当期の売上高は、前期比17.7%増の29億9千8百万円となりました。

一般電子部品
スイッチング電源、液晶ディスプレイ、パネルPCなどを中心に拡販に努めましたが、前期に伸長した特定顧客向けデジタルビデオカメラ用液晶モニターの売上の減少をカバーできなかった結果、当期の売上高は、前期比10.2%減の29億4千4百万円となりました。

2005年3月期業績見通し (2004年4月28日)

世界経済の回復に伴い、輸出や設備投資が増加基調にあることから、景気は回復傾向を持続するものと予想します。また、エレクトロニクス業界におきましては、引き続きデジタル家電が牽引役となり、堅調に推移するものと考えています。

こうした状況のもと、2005年3月期の業績見通しは、売上高は前期比5.0%増の900億円、経常利益は前期比8.4%増の32億円、当期純利益は前期比10.1%増の18億5千万円を見込んでいます。

株式分割(無償交付)のお知らせ (2004年6月22日)

投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えるため、2004年7月31日を基準日として、2004年9月15日付で1株につき2株の割合で株式の分割を行います。

また、配当起算日は2004年4月1日とし、1株当たりの年間配当金は中間・期末とも2千5百円(年間5千円)を予定しています。

財務諸表

貸借対照表

単位：千円

科目	2003.3	2004.3	比較増減
資産の部			
流動資産	32,063,060	34,502,592	2,439,532
現金及び預金	483,141	638,591	155,449
受取手形	1,202,165	991,936	210,228
売掛金	18,687,580	19,449,179	761,598
商品	11,004,478	12,555,147	1,550,668
前渡金	297		297
前払費用	41,750	40,885	864
繰延税金資産	208,333	428,387	220,053
未収消費税等	445,782	391,781	54,000
その他	17,572	12,819	4,752
貸倒引当金	28,042	6,136	21,906
固定資産	2,978,341	2,921,638	56,703
有形固定資産	326,906	346,856	19,949
建物	128,403	128,932	529
構築物	357	318	38
工具、器具及び備品	198,146	217,604	19,458
無形固定資産	568,366	368,548	199,818
ソフトウェア	562,585	362,664	199,921
電話加入権	5,781	5,884	102
投資その他の資産	2,083,067	2,206,233	123,165
関係会社出資金		20,785	20,785
従業員長期貸付金	4,005		4,005
長期差入保証金	1,155,672	1,007,145	148,527
長期前払費用	20,419	14,932	5,487
繰延税金資産	844,399	1,104,877	260,478
その他	60,422	60,547	125
貸倒引当金	1,851	2,055	204
資産合計	35,041,402	37,424,231	2,382,829

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

資産の部

資産合計は、前期比23億8千2百万円増の374億2千4百万円となりました。

流動資産は、売上増加による売掛金および棚卸資産の増加等により、前期比24億3千9百万円増の345億2百万円となりました。

固定資産は、投資その他の資産の繰延税金資産等が増加したものの、無形固定資産のソフトウェアの減価償却による減少等により、前期比5千6百万円減の29億2千1百万円となりました。

単位：千円

科目	2003.3	2004.3	比較増減
負債の部			
流動負債	12,833,124	13,569,073	735,949
買掛金	5,948,649	7,612,395	1,663,746
短期借入金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
未払金	973,596	1,219,625	246,029
未払費用	2,114	188,525	186,411
未払法人税等	1,008,008	1,036,299	28,291
前受金	80,624	30,441	50,183
預り金	64,854	58,054	6,800
賞与引当金	255,277	351,580	96,303
その他		72,151	72,151
固定負債	10,604,317	11,080,068	475,750
長期借入金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当金	2,424,932	2,859,528	434,595
役員退職慰労引当金	50,385	69,740	19,355
その他	129,000	150,800	21,800
負債合計	23,437,441	24,649,141	1,211,699
資本の部			
資本金	2,495,750	2,495,750	
資本剰余金	2,054,850	2,054,850	
資本準備金	2,054,850	2,054,850	
利益剰余金	7,053,360	8,224,489	1,171,129
利益準備金	200,000	200,000	
任意積立金			
別途積立金	5,000,000	6,000,000	1,000,000
当期末処分利益	1,853,360	2,024,489	171,129
資本合計	11,603,960	12,775,089	1,171,129
負債及び資本合計	35,041,402	37,424,231	2,382,829

負債・資本の部

負債合計は、前期比12億1千1百万円増の246億4千9百万円となりました。

流動負債は、仕入増に伴う買掛金や賞与引当金の増加、短期借入金の減少により、前期比7億3千5百万円増の135億6千9百万円となりました。

固定負債は、退職給付引当金の増加等により、前期比4億7千5百万円増加の110億8千万円となりました。

資本合計は、当期純利益の計上による増加等により、前期比11億7千1百万円増の127億7千5百万円となりました。

損益計算書

単位：千円

科目	2003.3	2004.3	比較増減
売上高	78,811,874	85,738,254	6,926,380
売上原価	68,423,269	74,361,241	5,937,972
商品期首たな卸高	9,640,453	11,004,478	
当期商品仕入高	69,787,293	75,911,910	
合計	79,427,747	86,916,389	
商品期末たな卸高	11,004,478	12,555,147	
売上総利益	10,388,604	11,377,012	988,408
販売費及び一般管理費	7,390,528	8,194,845	804,316
役員報酬	108,056	131,735	
従業員給料手当	2,591,563	2,693,349	
従業員賞与	250,473	591,890	
賞与引当金繰入額	255,277	351,580	
退職給付引当金繰入額	562,316	705,604	
法定福利費	369,443	387,212	
旅費及び交通費	446,634	481,315	
減価償却費	493,100	385,140	
電算機経費	637,605	678,169	
地代家賃	446,504	432,059	
研究開発費	34,881	29,225	
その他	1,194,670	1,327,562	
営業利益	2,998,076	3,182,167	184,091
営業外収益	27,800	30,478	2,677
受取利息	1,025	507	
セミナー開催収入	6,078	6,614	
受取保険金	3,080		
受取保険配当金	11,627	13,250	
保険事務手数料	2,910	2,916	
その他	3,078	7,188	
営業外費用	451,106	260,454	190,652
支払利息	162,175	119,816	
債権譲渡損	69,626	90,343	
新株発行費	26,774	4,240	
為替差損	187,367	37,986	
その他	5,163	8,065	
経常利益	2,574,770	2,952,191	377,420
特別利益	9,011	21,912	12,900
前期損益修正益	6,168		
貸倒引当金戻入益	1,468	21,912	
ゴルフ会員権売却益	1,374		
特別損失	4,241	3,242	999
固定資産除却損	1,733	3,032	
ゴルフ会員権評価損	2,284		
貸倒引当金繰入額	224	210	
税引前当期純利益	2,579,540	2,970,861	391,320
法人税、住民税及び事業税	1,473,325	1,770,763	
法人税等調整額	317,516	480,532	
当期純利益	1,423,731	1,680,629	256,897
前期繰越利益	429,628	539,360	109,731
中間配当額		195,500	195,500
当期末処分利益	1,853,360	2,024,489	171,129

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

売上高・利益

売上高は、前期比8.8%増の857億3千8百万円となりました。

営業利益は、退職給付引当金繰入額等により販売費および一般管理費が増加したものの、前期比6.1%増加の31億8千2百万円となりました。

経常利益は、為替差損、支払利息が減少したこと等により、前期比14.7%増の29億5千2百万円となりました。

当期純利益は、貸倒引当金戻入益の増加により、前期比18.0%増の16億8千万円となりました。

キャッシュ・フロー計算書(要約)

単位：千円

科目	2003.3	2004.3	比較増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,086,321	2,399,595	313,274
投資活動によるキャッシュ・フロー	274,938	243,539	31,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,606,299	1,998,740	392,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,068	1,865	10,933
現金及び現金同等物の増加額	214,152	155,449	58,702
現金及び現金同等物の期首残高	268,989	483,141	214,152
現金及び現金同等物の期末残高	483,141	638,591	155,449

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

キャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、23億9千9百万円の収入となりました。主として、売上高の増加に伴う支払増加要因等があったものの、それを上回る税引前当期純利益を計上できたためです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億4千3百万円の支出となりました。主として、営業拠点開設に伴う建物附属設備の取得や半導体書込み用機器の取得による支出および社内コンピュータシステム開発費の支払い等のためです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、19億9千8百万円の支出となりました。これは短期借入金の返済および配当金の支払いを行ったためです。

以上の結果、当期末における現金および現金同等物は、前期比1億5千5百万円増の6億3千8百万円となりました。

利益処分

単位：千円

科目	2003.3	2004.3	比較増減
当期末処分利益	1,853,360	2,024,489	171,129
利益処分量	1,314,000	1,445,800	131,800
配当金	299,000	220,800	78,200
取締役賞与金	15,000	25,000	10,000
任意積立金			
別途積立金	1,000,000	1,200,000	200,000
次期繰越利益	539,360	578,689	39,329

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

配当金

中間配当8,500円、期末配当4,800円(2003年11月20日株式分割1:2)とし、年間配当額は13,300円とさせていただきます。配当性向は前期比9.8ポイント増の25.1%となりました。

財務データ

収益性



(単位: 百万円)

	2000.3	2001.3	2002.3	2003.3	2004.3
売上高	74,421	92,546	74,629	78,811	85,738
売上原価率(%) *1	86.8	86.1	87.1	86.8	86.7
営業利益	2,966	4,687	2,647	2,998	3,182
営業利益率(%) *2	4.0	5.1	3.5	3.8	3.7
経常利益	2,738	4,852	2,523	2,574	2,952
経常利益率(%) *3	3.7	5.2	3.4	3.3	3.4
当期純利益	1,621	2,150	1,447	1,423	1,680
当期純利益率(%) *4	2.2	2.3	1.9	1.8	2.0
株主資本当期純利益率(ROE)(%) *5	59.8	48.8	24.2	15.7	13.8
総資本当期純利益率(ROA)(%) *6	5.7	5.1	3.4	4.2	4.6

*1. 売上原価率 = 売上原価 ÷ 売上高
 *2. 営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高
 *3. 経常利益率 = 経常利益 ÷ 売上高
 *4. 当期純利益率 = 当期純利益 ÷ 売上高

*5. 株主資本当期純利益率(ROE)
 = 当期純利益 ÷ 期首・期末平均株主資本
 *6. 総資本当期純利益率(ROA)
 = 当期純利益 ÷ 期首・期末平均総資産

効率性・安全性



(単位: 百万円)

	2000.3	2001.3	2002.3	2003.3	2004.3
総資産	31,472	52,237	33,454	35,041	37,424
総資産回転率(回) *1	2.6	2.2	1.7	2.3	2.4
棚卸資産	9,385	16,268	9,640	11,004	12,555
棚卸資産回転率(回) *2	9.8	7.2	5.8	7.6	7.3
債権回転率(回) *3	4.0	3.8	3.0	3.9	4.3
仕入債務回転率(回) *4	11.1	10.3	9.6	12.8	11.0
流動資産	29,931	48,593	30,388	32,063	34,502
流動比率(%) *5	123.3	132.1	155.4	249.8	254.3
負債総額	28,055	46,839	26,875	23,437	24,649
負債比率(%) *6	820.9	867.6	408.5	202.0	192.9
株主資本	3,417	5,398	6,579	11,603	12,775
株主資本比率(%) *7	10.9	10.3	19.7	33.1	34.1

*1. 総資産回転率 = 売上高 ÷ 期首・期末平均総資産
 *2. 棚卸資産回転率 = 売上高 ÷ 期首・期末平均棚卸資産
 *3. 債権回転率 = 売上高 ÷ 期首・期末平均(受取手形 + 売掛金)
 *4. 仕入債務回転率 = 売上原価 ÷ 期首・期末平均買掛金
 *5. 流動比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
 *6. 負債比率 = 負債 ÷ 株主資本
 *7. 株主資本比率 = 株主資本 ÷ 総資産

その他の指標



	2000.3	2001.3	2002.3	2003.3	2004.3
一株当たり当期純利益(EPS) *1	405	134	90	84	35
一株当たり株主資本 *2	854	337	411	503	277
株価収益率(PER: %) *3				5.3	16.0
株価純資産倍率(PBR: 倍) *4				0.9	2.1
一株当たり配当金(円) *5	37,500	12,500	9,375	13,000	13,300
発行済株式数(株)	4,000	16,000	16,000	23,000	46,000
配当金	150,000	200,000	150,000	299,000	416,300
配当性向(%) *6	9.3	9.3	10.4	15.3	25.1
従業員一人当たり当期純利益 *7	3,595	4,380	2,821	2,681	3,147
従業員数(人)	451	491	513	531	534

*1. 一株当たり当期純利益(EPS)

= 当期純利益 ÷ 期中平均発行済株式総数

*2. 一株当たり株主資本 = 期末株主資本 ÷ 期末発行済株式総数

*3. 株価収益率(PER) = 株価(期末) ÷ 一株当たり当期純利益

*4. 株価純資産倍率(PBR) = 株価(期末) ÷ 一株当たり株主資本

*5. 一株当たり配当金 = 配当金 ÷ 発行済株式数

*6. 配当性向 = 配当金総額 ÷ 当期純利益

*7. 従業員一人当たり当期純利益 = 当期純利益 ÷ 期末従業員数

会社概要

商号 東京エレクトロン デバイス株式会社
TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED
設立 1986年3月3日
代表者 取締役社長 砂川 俊昭
売上高 857億円(2004年3月期)
従業員数 534名(2004年3月末日現在)
本社 〒224-0045 神奈川県横浜市都筑区東方町1番地
TEL: 045-474-7000(代表)
FAX: 045-474-7092
http://www.teldevice.co.jp/



本社

取締役および監査役(2004年6月18日現在)

代表取締役社長 砂川 俊昭	取締役 佐藤 潔
取締役 遠山 憲一	取締役 原 護
取締役 小谷 浩	常勤監査役 矢崎 一洋
取締役 佐藤 均	常勤監査役 木村 嘉男
取締役 武井 弘	監査役 糸山 武敏
取締役 東 哲郎	監査役 原田 芳輝

(注)1. 取締役のうち東哲郎氏及び佐藤潔氏は、商法第188条第2項第7号ノ2に定める社外取締役であります。
2. 監査役のうち矢崎一洋氏、木村嘉男氏、糸山武敏氏及び原田芳輝氏は、「株式会社」の監査等に関する商法の特例に関する法律「第18条第1項に定める社外監査役」であります。

拠点網(国内)

北関東支社	仙台営業所	仙台設計開発センター
長岡サテライト	水戸営業所	横浜設計開発センター
東京サテライト	立川営業所	
	横浜営業所	
大阪支社	松本営業所	
京都サテライト	名古屋営業所	
岡山サテライト	福岡営業所	
	横浜オフィス	

株式情報(2004年3月31日現在)

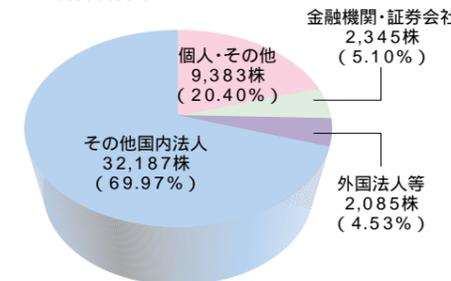
株式の状況

会社が発行する株式の総数.....128,000株
発行済株式の総数.....46,000株
資本金.....2,495,750,000円
株主数.....2,377名
上場証券取引所.....東京証券取引所 市場第二部
証券コード.....2760
名義書換代理人.....中央三井信託銀行株式会社
公告の方法.....日本経済新聞
(決算公告はhttp://www.teldevice.co.jp/kessan.htmlで提供)

大株主の状況

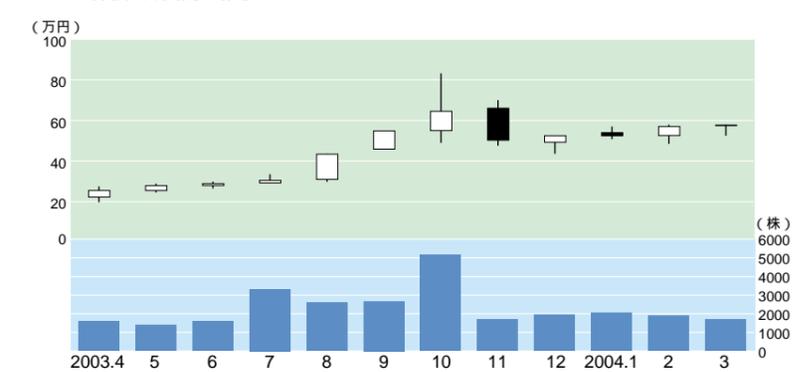
株主名	当社への出資状況	
	持株数(株)	議決権比率(%)
東京エレクトロン株式会社	32,000	69.56
東京エレクトロン デバイス社員持株会	1,338	2.90
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	943	2.05
ゴールドマン・サックス・インターナショナル	646	1.40
日本証券金融株式会社	560	1.21

所有者別状況



(注)2003年11月20日付で当社普通株式1株を2株に分割いたしました。これにより、発行済株式の総数は23,000株増加して46,000株となっております。また、これに伴い、平成15年8月28日開催の取締役会決議に基づき、2003年11月20日付をもって会社が発行する株式の総数を64,000株増加させ128,000株に変更しております。

株価・売買高の推移(2003年4月から2004年3月まで)



(注)株式分割に伴う権利落日以前の株価については、遡及して修正を行っております。(株式分割基準日 2003年9月)